

性能特点

- 在低压力下达到低热阻的效果
- 硬度低，贴合性好
- 卓越的耐高低温性，极好的耐气候性、耐辐射及卓越的介电性能
- 卓越的化学和机械稳定性
- 应力低，更为有效地保护电器元件

产品描述

PAKCOOL® TP-215 导热垫片在设计上成功融合了高导热特性、柔软及弹性等优势。本系列产品具备广泛的导热系数，能够适应不同的应用场景。本产品为电绝缘材料，即使在较低的压力下，也能有效填充热源与散热器之间的空隙，确保优异的热传导效果。本产品在压强 20-100 psi (0.14-0.69 MPa) 的压力下具有最佳导热性能。本产品规格灵活，可根据客户需求定制尺寸。

本产品在其表面都具有一定的黏性。在使用时无需附加其他影响导热性能的粘合剂从而更便于大规模生产加工。在所有的垫片的两面都附有易剥落的防尘薄膜。

典型应用

- LED
- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 通讯设备
- 计算机及其附件

技术参数

特性	TP-215	测试方法
颜色	粉红色	目测
导热系数 (W/m·K)	1.5	ASTM D5470
热阻@20psi, 0.5mm (K-in ² /W)	0.76	ASTM D5470
厚度* (mm)	0.3—5.0	ASTM D374
密度 (g/cm ³)	2.20±0.05	ASTM D792
硬度 (Shore 00)	50±10	ASTM D2240
抗拉强度 (Psi)	≥40	ASTM D412
体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0×10 ¹³	ASTM D257
介电强度 (kV/mm)	≥12	ASTM D149
介电常数 (100KHz)	4.5	ASTM D150
阻燃性	V-0	UL94
连续使用温度 (°C)	-40~200	--
*标准厚度 (mm): 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5		

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

产品配置

- 可根据客户的要求进行裁切
- 无背胶
- 标准尺寸为 200mm × 400mm, 也可根据客户要求定制

包装储运

- 常温、通风干燥处保存、避免阳光直射
- 建议储存期限：24 个月

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。